

证券代码：300480

证券简称：光力科技

光力科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260529

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	新华资产；兴业基金；银华基金；润晖投资；诺安基金；财通基金；新华基金；圣熙资产；信迹投资；风实投资；林孚私募；太和投资；银灞基金；安源资产；汉景资本；威拜基金；承风金萍私募、平安证券；国信证券；长江证券；上海证券；诚通证券；九方云智能；东方财富证券。
时间	2026年5月27日-29日
地点	公司郑州航空港厂区2号楼会议室、武汉
上市公司接待人员姓名	总经理、董事：胡延艳 董事会秘书：吕琦 证券事务代表：关平丽
投资者关系活动主要内容介绍	<p>管理层介绍了公司业务经营情况，部分投资者实地参观了公司生产车间和展厅区域；公司参加了2026年5月29日长江证券策略会，并就投资者关注的问题进行交流。主要交流内容如下：</p> <p>1、公司目前营收结构如何，两个业务板块2026年的发展预期？</p> <p>答：2025年公司半导体业务营收占比达53.99%，国内半导体设备营收规模首次超越海外子公司设备收入。2026年一季度半导体业务占比持续提升，国内业务营收已反超海外业务。</p> <p>目前半导体行业处于上行周期，公司半导体业务预期后续仍延续2025年下半年以来的良好趋势，半导体业务收入增速较快；公司物联网业务保持较为稳定发展。</p> <p>2、2026年一季度毛利率下降的原因是什么，公司的毛利率预期是否会提升？半导体业务的盈利能力能否持续？</p> <p>答：2026年一季度公司毛利率下降主要原因是半导体业务营收占比持续提升；随着公司国产半导体业务扭亏为盈，自研核心零部件的逐</p>

步导入应用以及半导体规模化效应进一步显现，长期来看公司半导体业务毛利率将会得到提升，盈利能力也将随之增强。

公司将紧跟行业发展趋势，围绕客户需求持续技术创新、产品迭代，不断推进精益生产、降本增效，确保公司盈利能力的稳步提升。

3、公司 25 年下半年以来产能满产，现在还是满产状态吗，公司有进一步提高现有产能的措施吗，二期项目预计什么时候可以投产？

答：公司国内半导体业务目前处于满产状态，公司将尽可能提升现有产能的生产效率，同时全力加紧航空港厂区二期产能扩建项目的建设进度以更好的满足客户的交付需求。航空港厂区二期项目预计于 2027 年一季度全部建成，公司也将根据市场需求变化动态调整产能提升的进度。

4、公司激光划片机和研磨机的进度？

答：公司激光开槽机、研磨机正在客户端验证，激光隐切机已试切多批样片，客户反馈良好，研磨抛光一体机正在进行研发样机的功能性测试。公司将全力加快推进产品验证尽快形成销售订单。

5、刀片的原材料是什么？公司刀片市场进度如何？

答：半导体划片刀的核心原材料主要包括金刚石微粉、结合剂等，根据金刚石颗粒尺寸、颗粒密度及结合剂的不同适用不同的应用场景。

子公司 ADT 软刀耗材处于行业领先地位，经过几十年的技术迭代和应用积累，性能稳定可靠，已有上千种型号软刀，产品持续销往全球包括头部封测企业在内的众多客户；国产化软刀已有部分型号实现批量供货，硬刀产品目前正在客户端验证。我们也将加快推动刀片耗材国产化进程。

6、介绍一下激光划片机和机械划片机的应用场景？

答：激光切割技术和传统机械切割应用于不同的工艺场景，两者主要是互补关系。

机械划片机通用性比较强，可以适配大多数场景下的划切需求，也是目前行业内使用最多的切割方式；激光开槽机主要用于 Low-k 薄膜、氮化铝、氧化铝陶瓷等材料的加工；激光隐切机主要用于对颗粒沾污、加工负荷承载要求比较高的工件（如超薄硅晶圆、MEMS 器件等）以及

	<p>硬脆材料（如第三代半导体器件）等的切割。</p> <p>7、公司共研机型占国产半导体设备业务销售比例是否有提升？</p> <p>答：目前公司的机械划切设备有二十余种型号，并可以根据客户的应用场景提供定制化的解决方案。目前公司国产半导体设备出货数量以标准机型为主，自 2025 年开始，定制共研型号设备的销量持续增长。</p> <p>8、公司空气主轴除了自用外有对外供货吗？供货规模如何？</p> <p>答：空气主轴等核心零部件作为公司的核心产品之一，除了可以服务半导体领域的客户外，还可以服务于众多精密制造领域；公司 2024 年与英国子公司组建核心零部件联合研发团队，加快不同类型空气主轴的市场拓展。除切割用主轴、研磨用主轴外，目前正在光学检测、汽车喷漆等多个半导体领域和非半导体领域向客户批量供货。</p> <p>9、公司刀片是仅能用于公司自己的划片机设备吗？</p> <p>答：刀片为通用化耗材，可适配国内外市场不同品牌的划片机；公司是业内少数同时具有半导体划切设备、空气主轴等核心零部件及刀片耗材的厂商，可根据客户不同场景的划切需求提供定制化的、最具性价比的解决方案。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 5 月 29 日